

2007年3月期 決算説明会

株式会社ディスコ

2007年5月11日
大和コンファレンスホール

「見通し」に関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動等があります。

本日の説明

1. 経営成績等について

代表取締役社長

溝呂木 育

2. 財務諸表について

常務取締役 IR室担当

関家圭三

3. 質疑応答

1. 経営成績等について

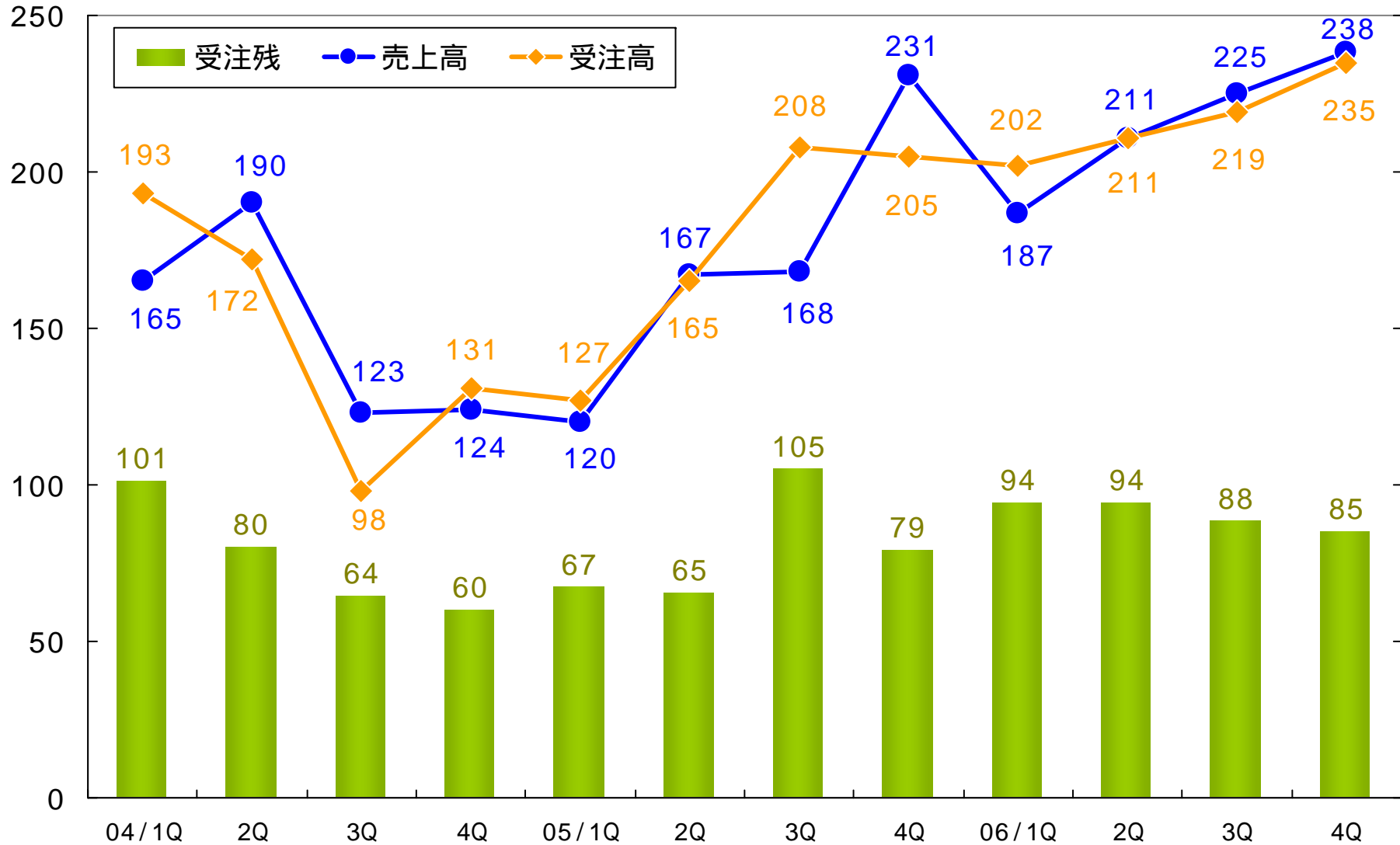
- ① 2007年3月期概況
- ② 2008年3月期見通し
- ③ 技術動向
- ④ 経営方針

1. 経営成績等について

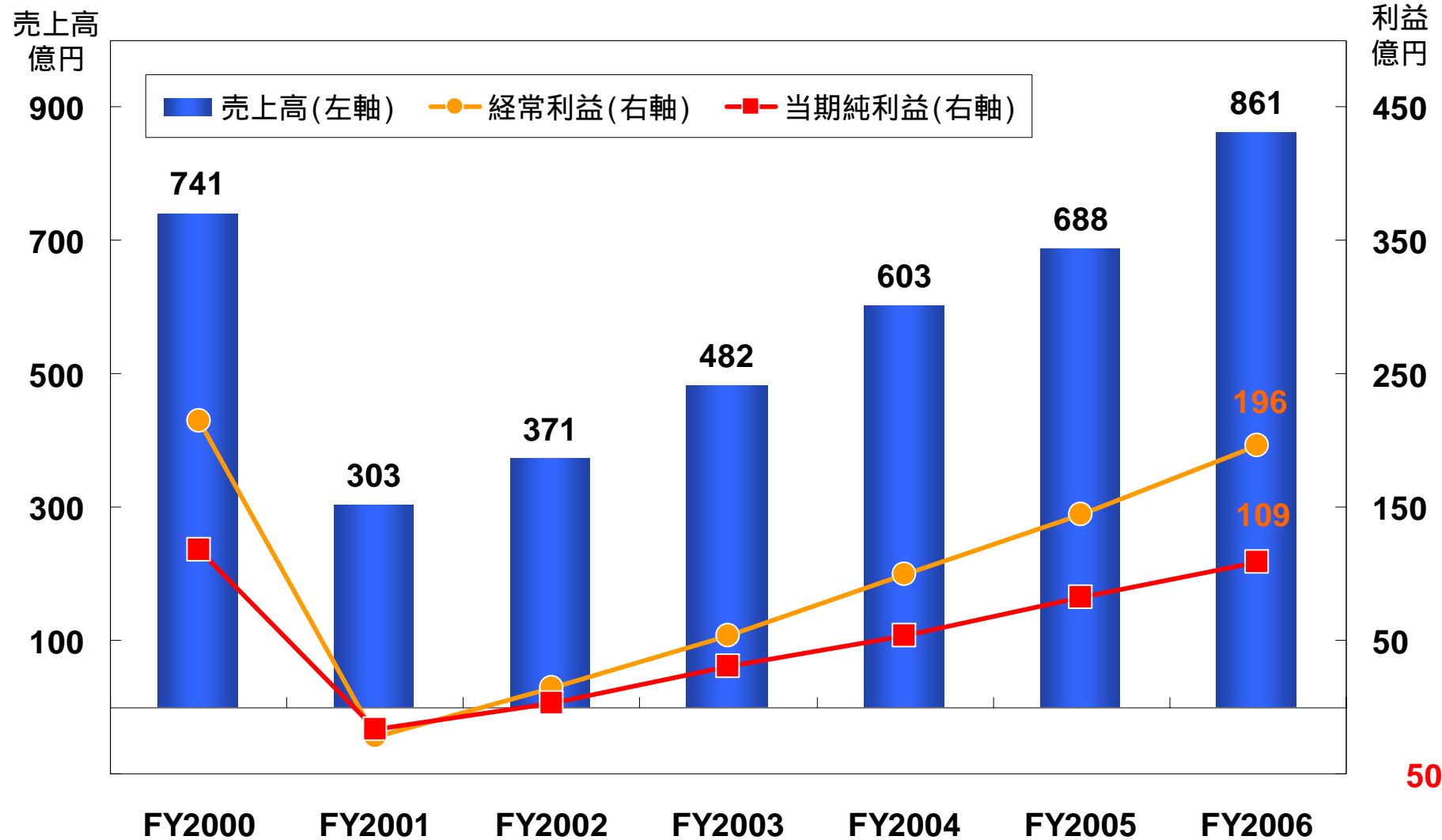
- ① 2007年3月期概況
- ② 2008年3月期見通し
- ③ 技術動向
- ④ 経営方針

連結 受注高・売上高推移

億円

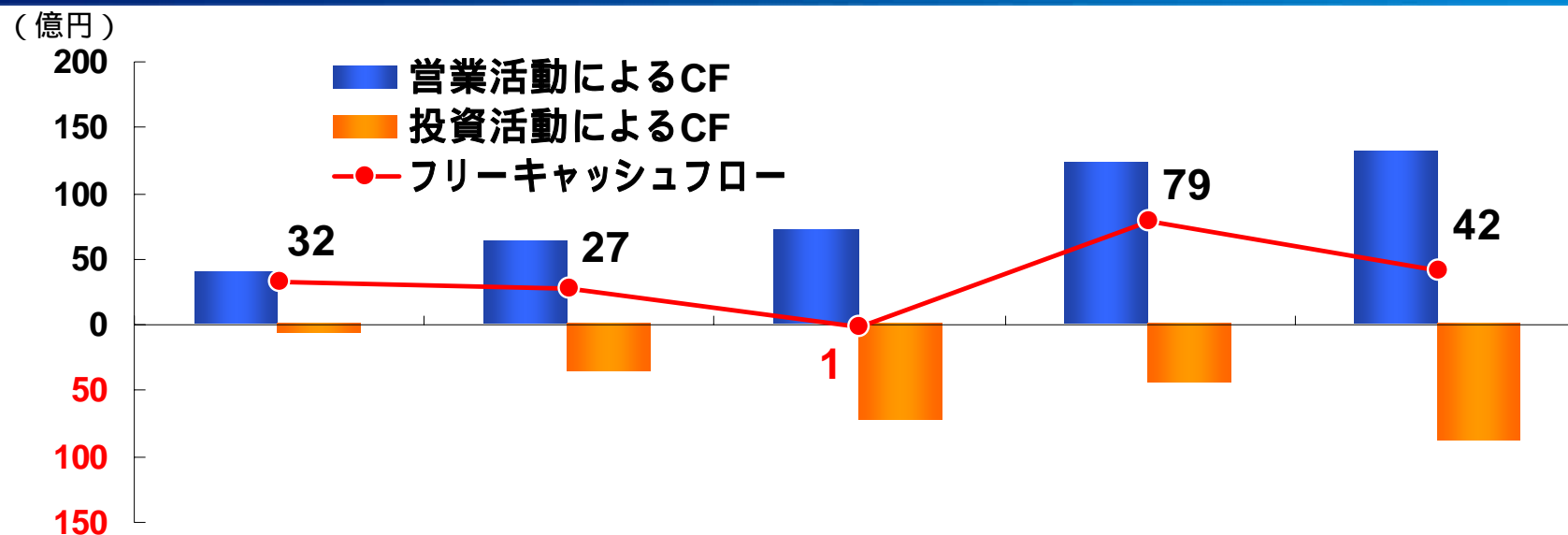


連結業績推移



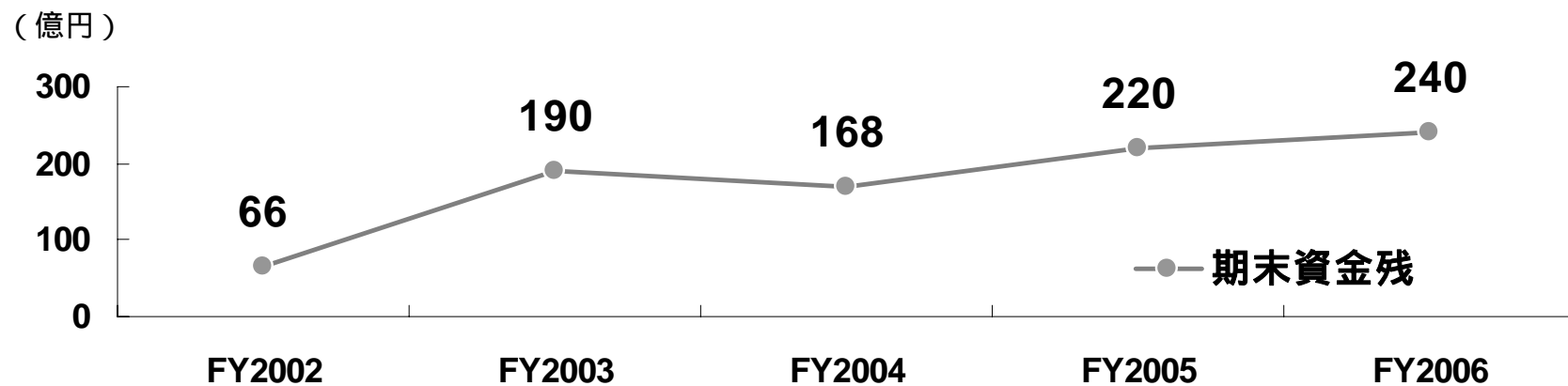
50

連結 キャッシュフロー推移

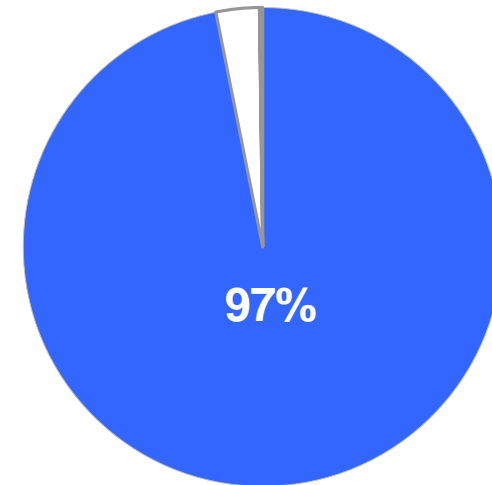
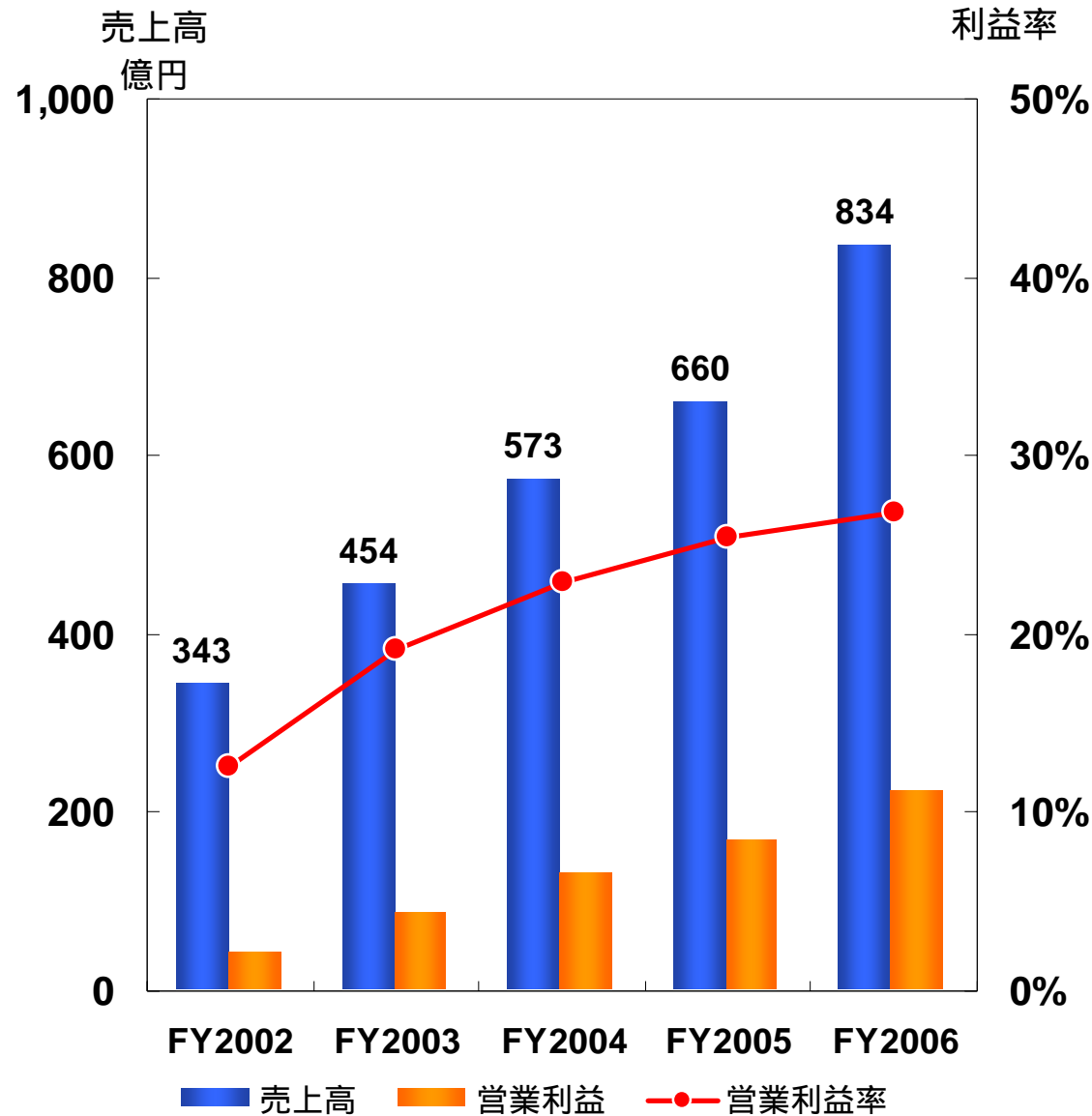


財務活動によるキャッシュフロー

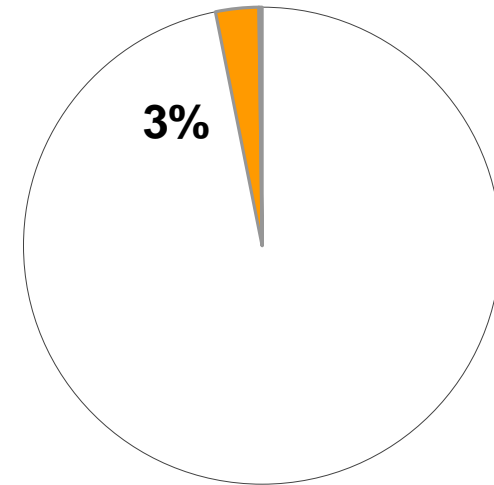
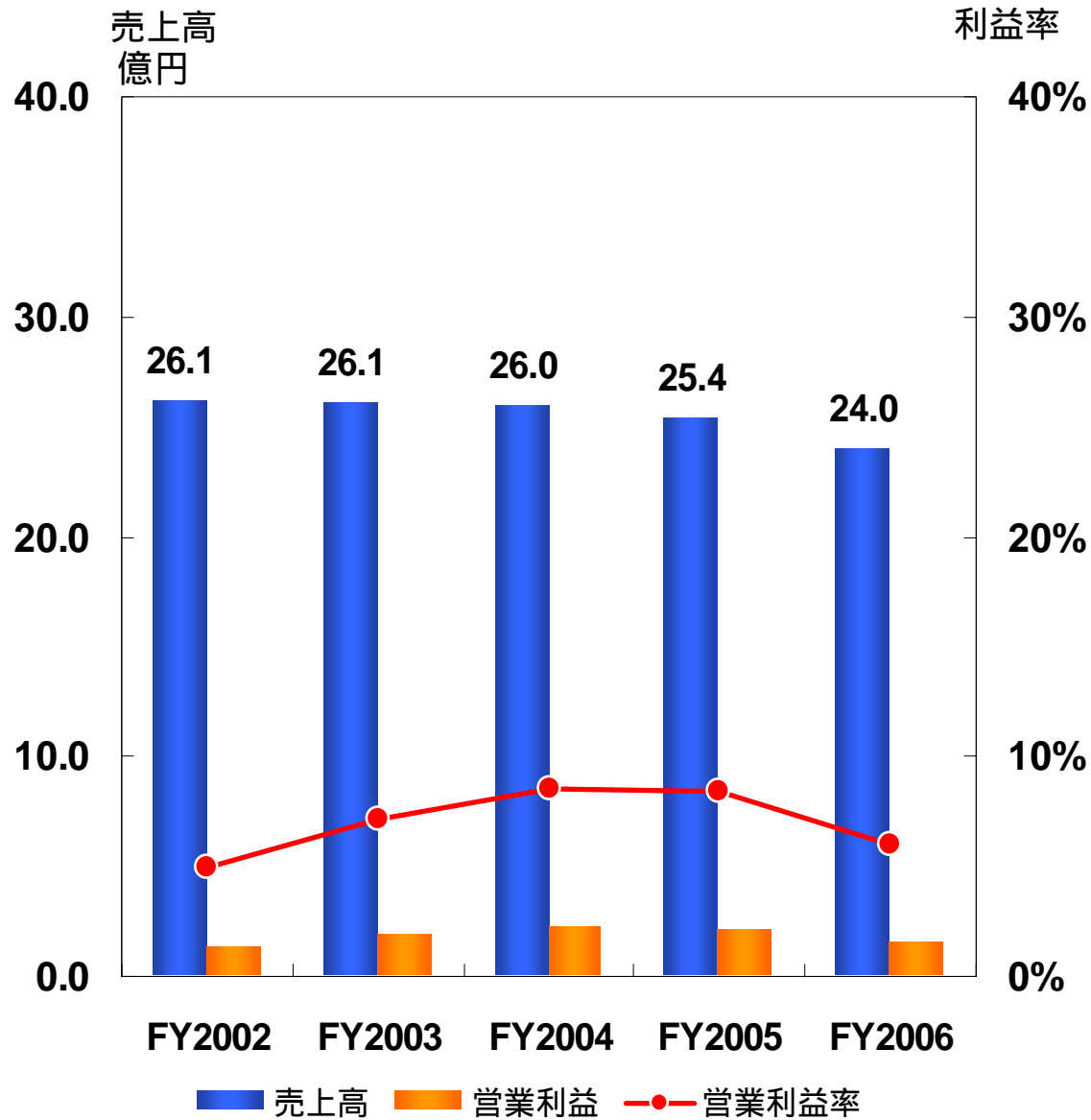
42億円 96億円 20億円 30億円 24億円



連結セグメント別：電子業界関連製品事業業績

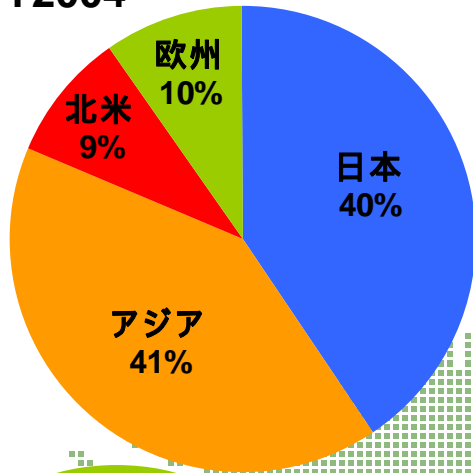


連結セグメント別：産業用研削製品事業業績

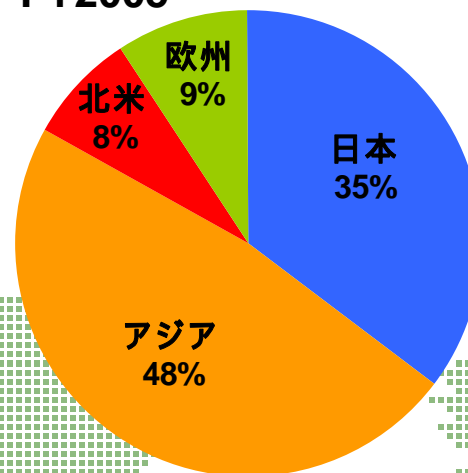


連結 地域別売上高推移

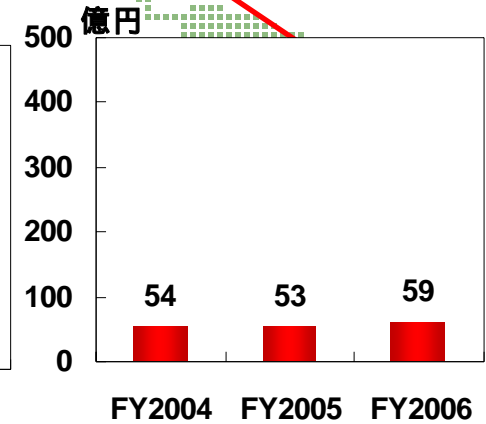
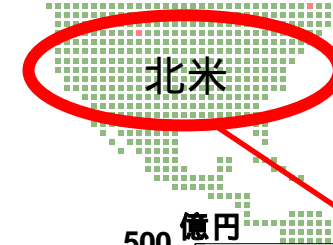
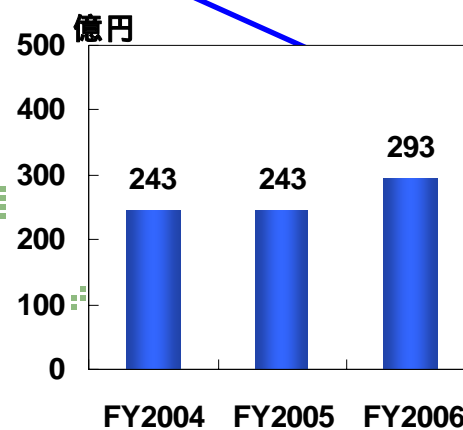
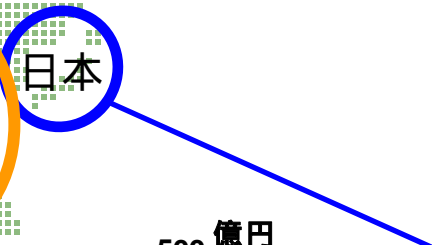
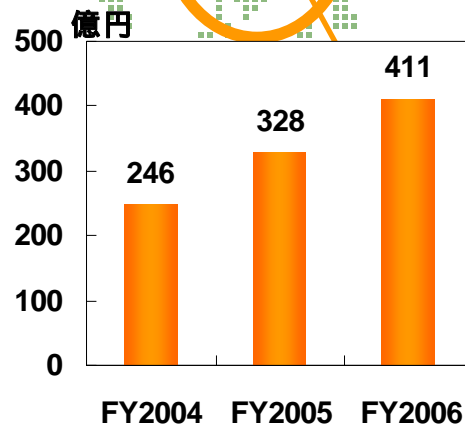
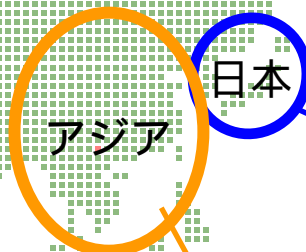
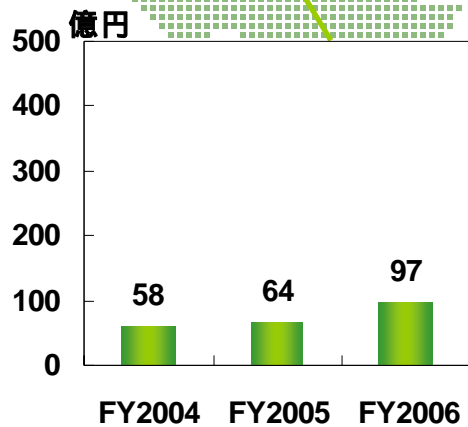
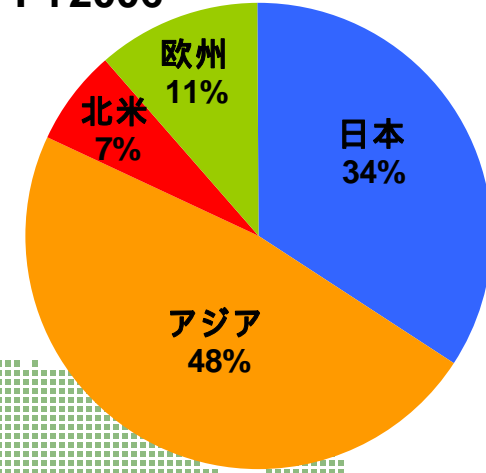
FY2004



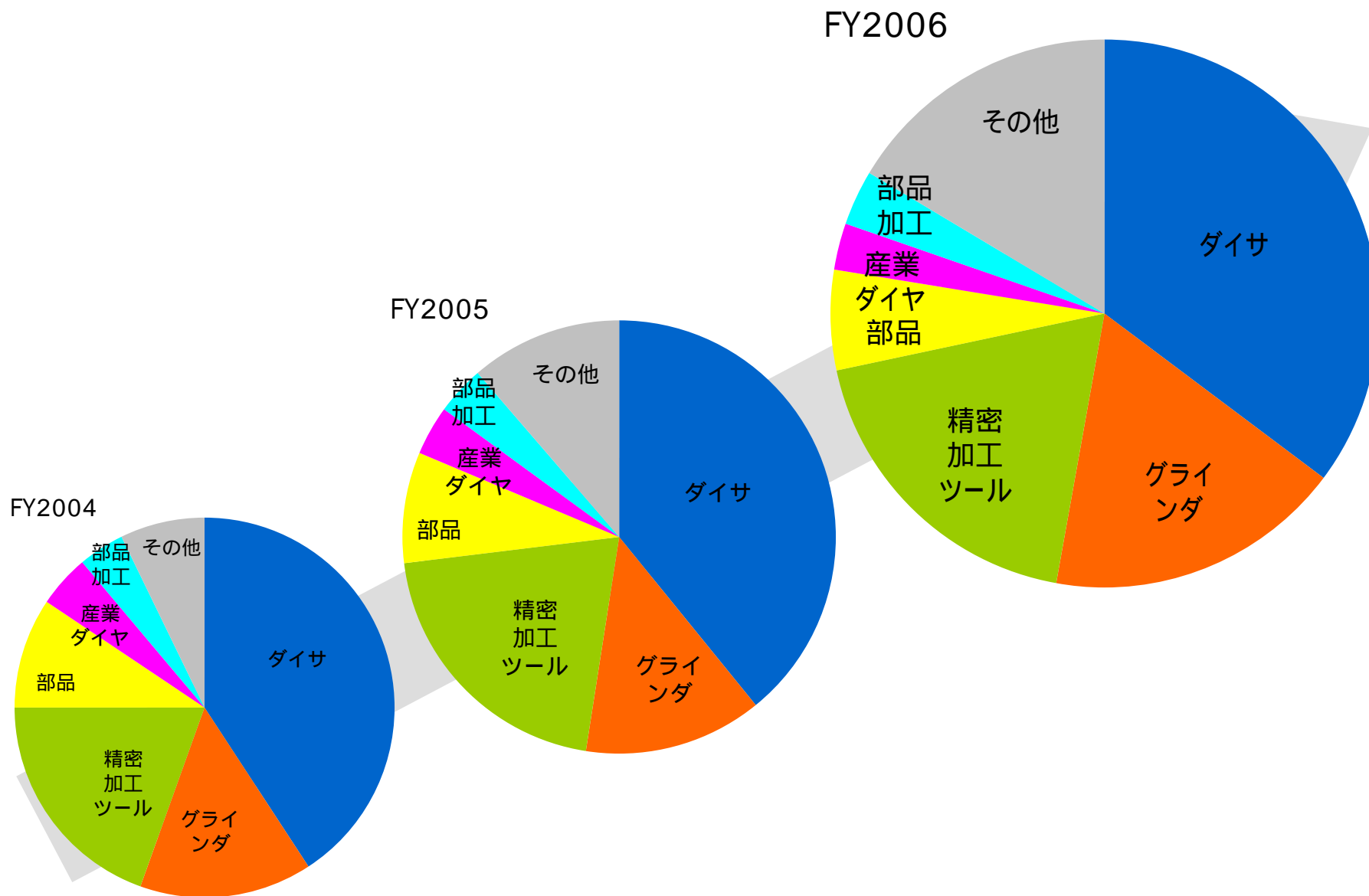
FY2005



FY2006

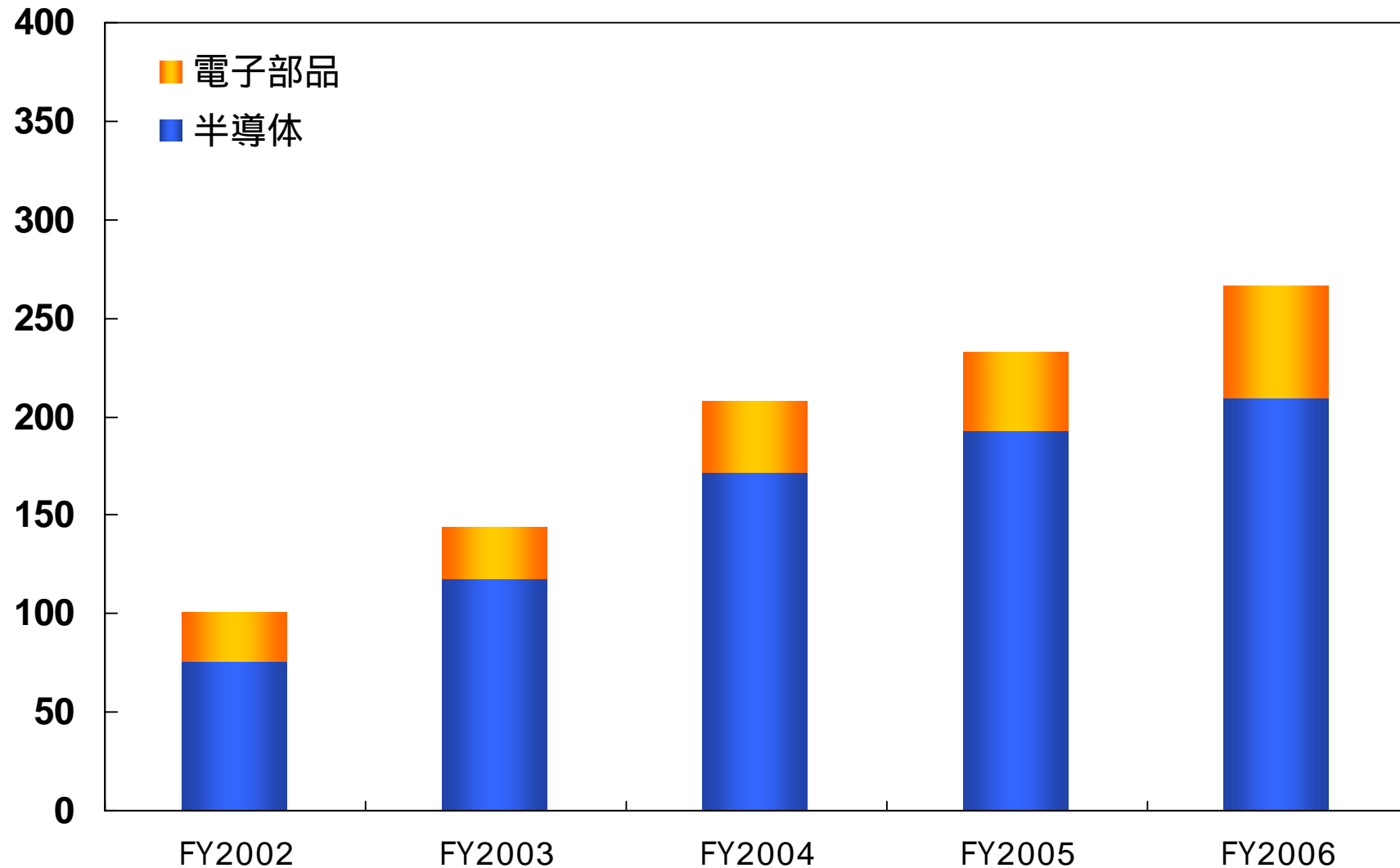


連結 製品群別売上高構成



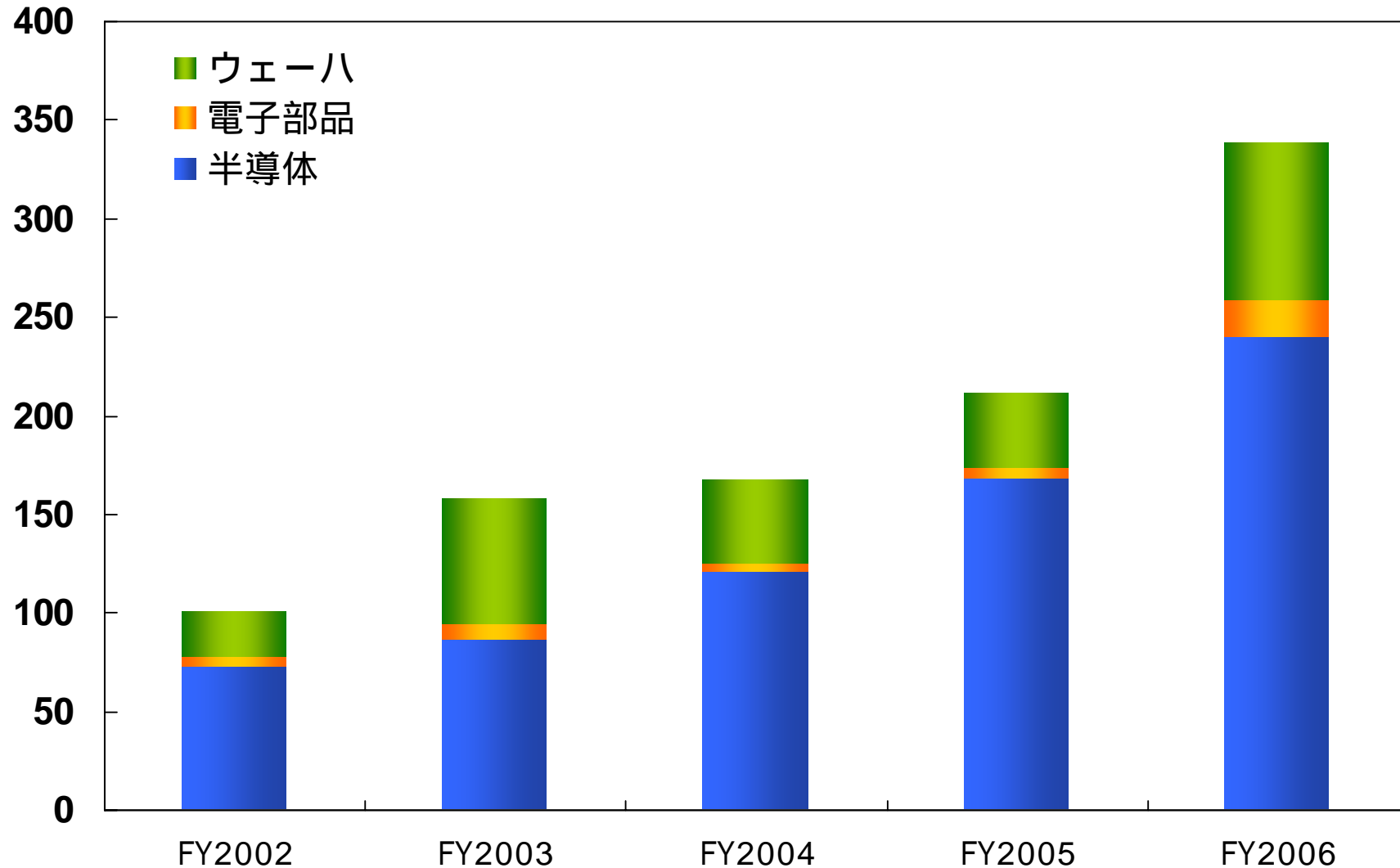
単独ダイサ用途別売上高推移

指数：FY2002=100



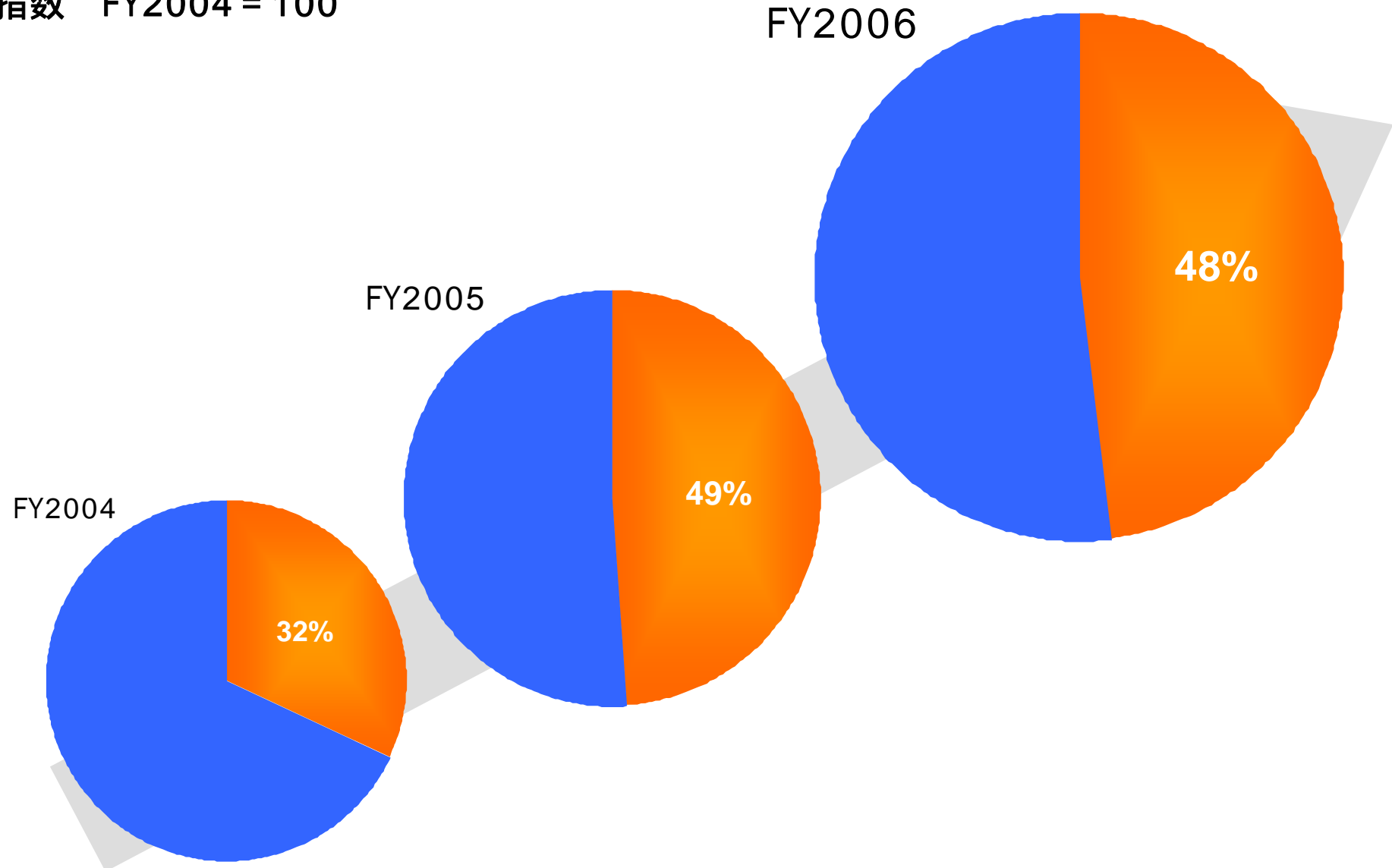
単独 グラインダ 用途別売上高推移

指数：FY2002=100



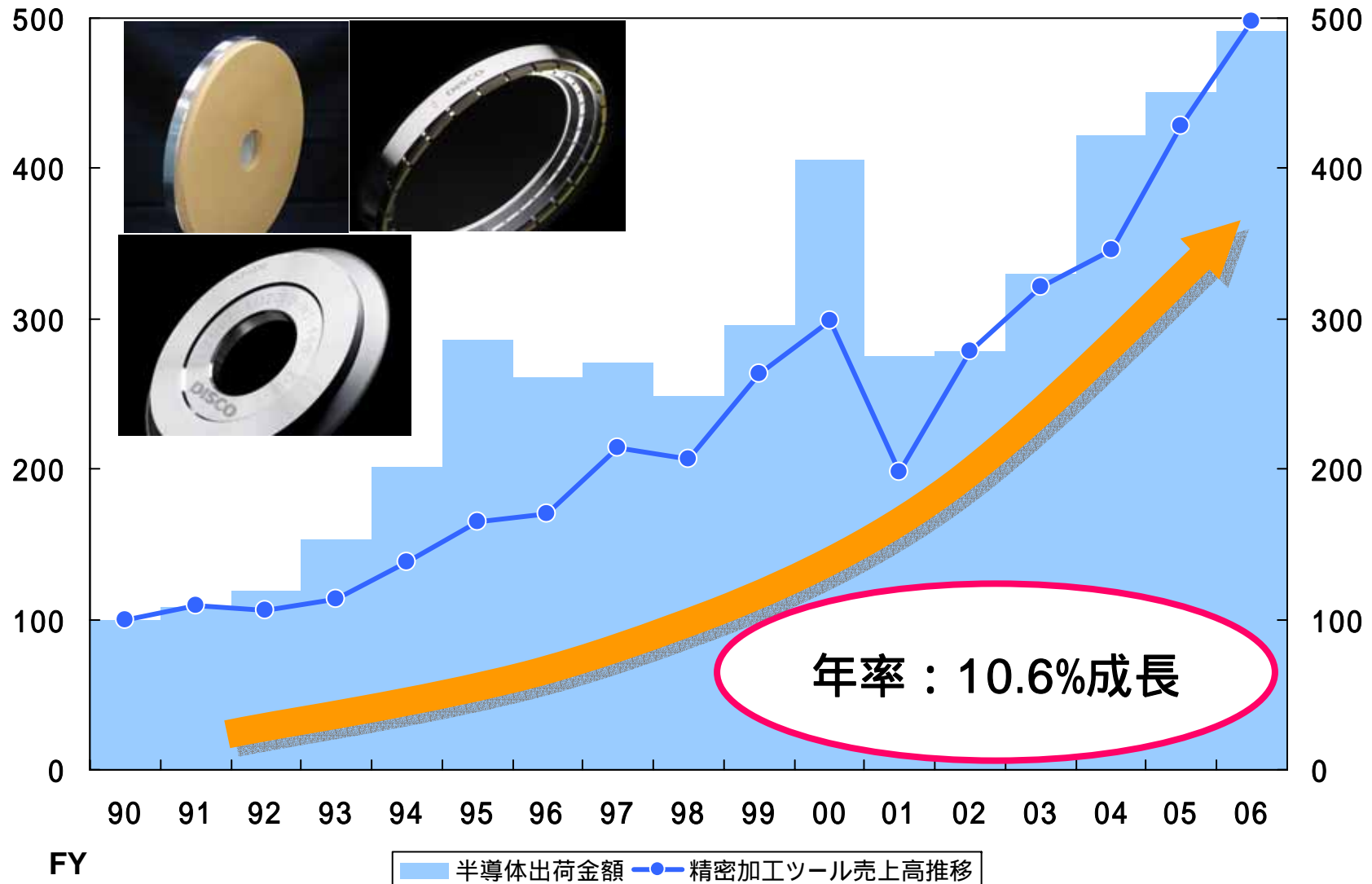
单独 300mm装置売上高推移

指数 FY2004 = 100



単独 精密加工ツール売上高推移

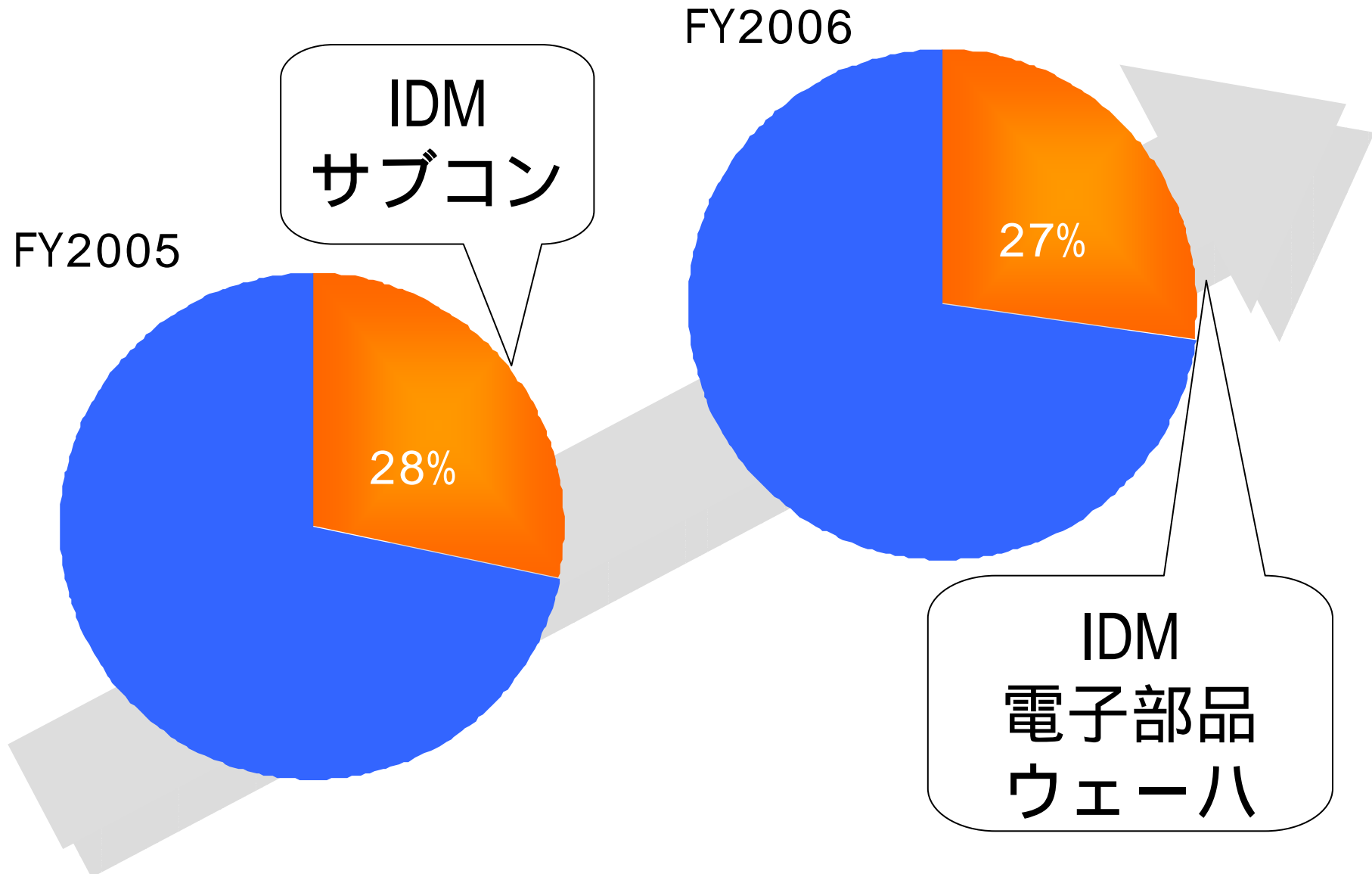
指数 FY1990 = 100



出典:WSTS

年平均成長率：FY1990-FY2006

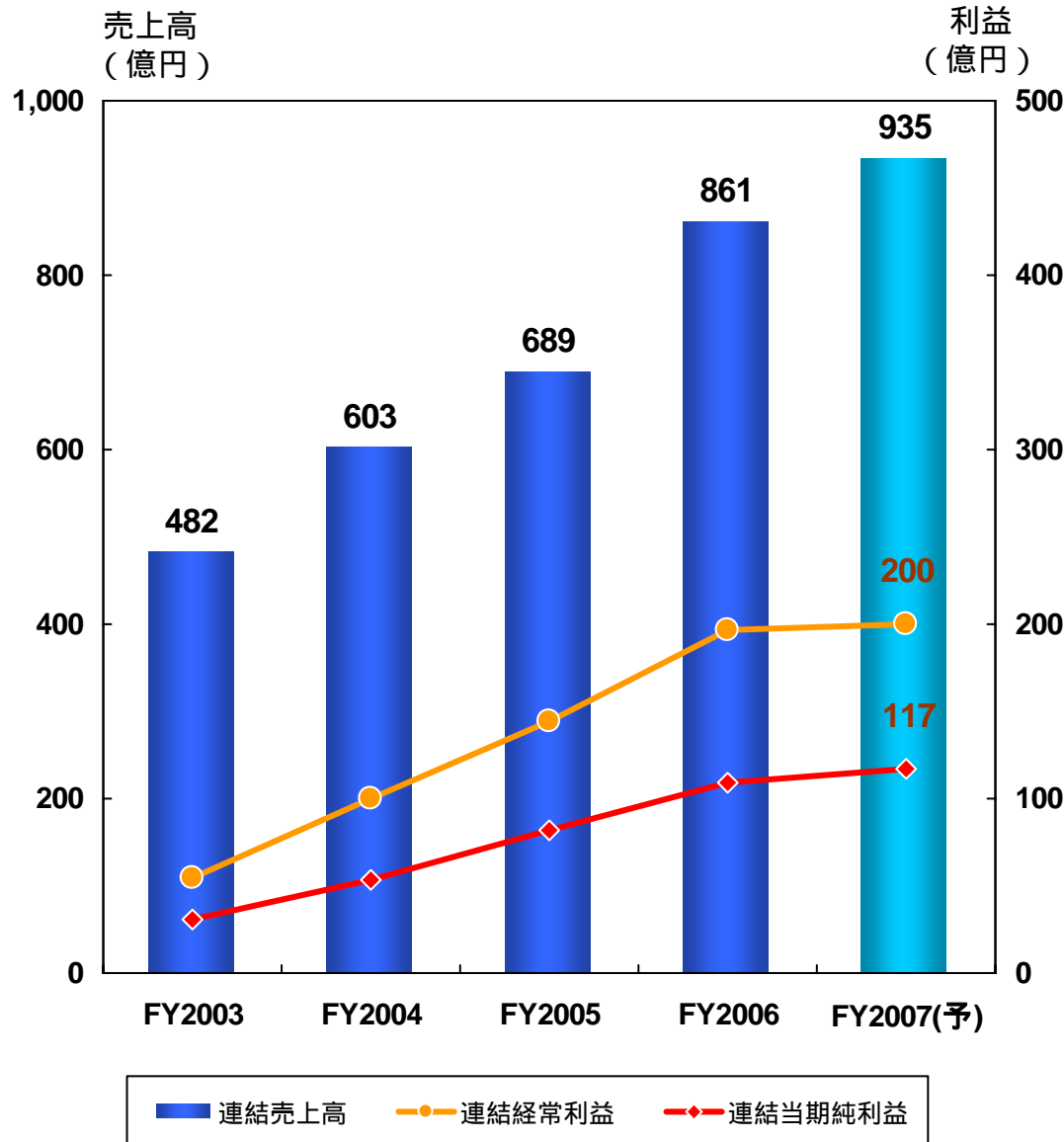
連結 Top 10顧客比率



1. 経営成績等について

- 1 2007年3月期概況
- 2 2008年3月期見通し**
- 3 技術動向
- 4 経営方針

2008年3月期連結業績見通し



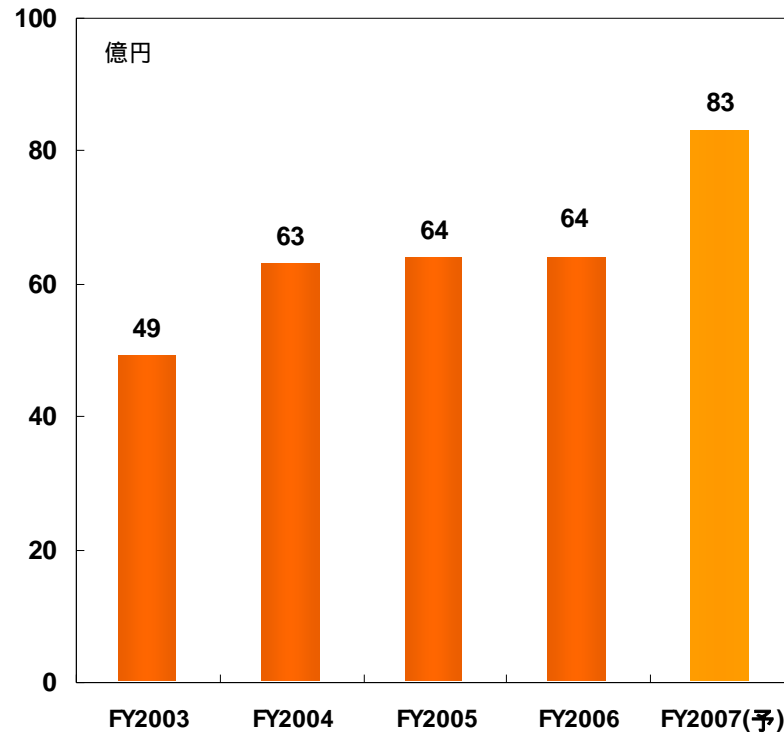
(億円)	07/3 通期 実績	08/3 中間期 見通し	08/3 通期 見通し
売上高	861	459	935
営業利益	195	97	200
経常利益	196	97	200
当期利益	109	59	117

(参考) 単独

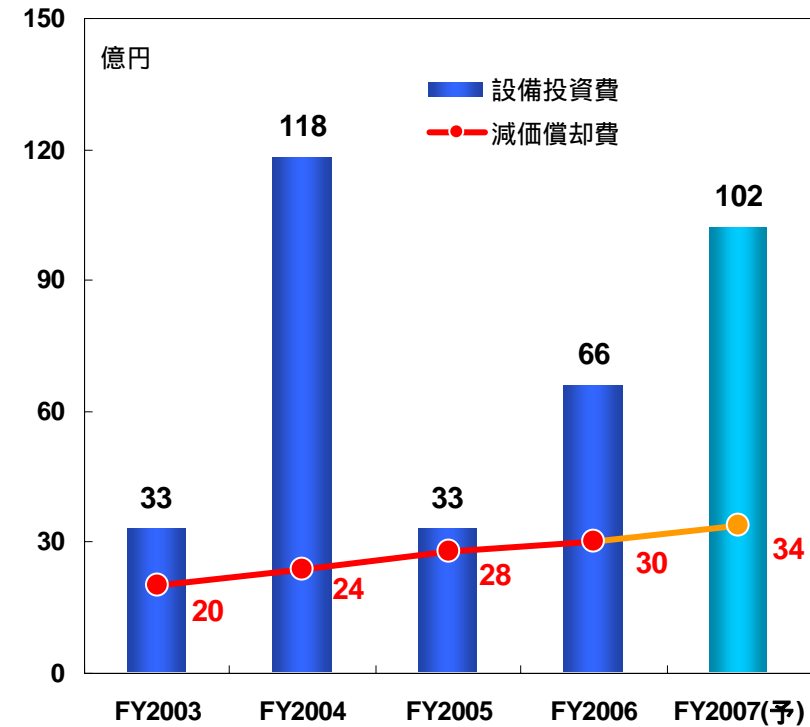
(億円)	07/3 通期 実績	08/3 中間期 見通し	08/3 通期 見通し
売上高	708	370	750
営業利益	166	82	166
経常利益	190	88	182
当期利益	107	54	112

連結 研究開発費/設備投資見通し

研究開発費



設備投資・減価償却費



注;研究開発費は04年度から運用の新基準ベース

(単位:百万円)	06年度実績	07年度見通し
研究開発費	6,414	8,300
設備投資	6,553	10,200
減価償却費	2,964	3,400

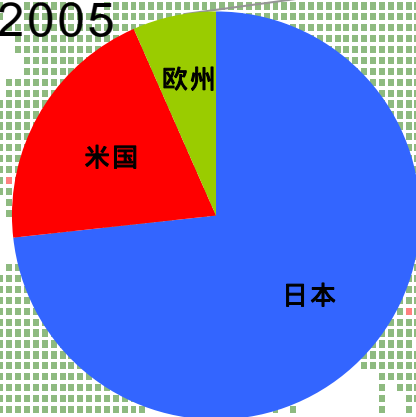
1. 経営成績等について

- 1 2007年3月期概況
- 2 2008年3月期見通し
- 3 技術動向**
- 4 経営方針

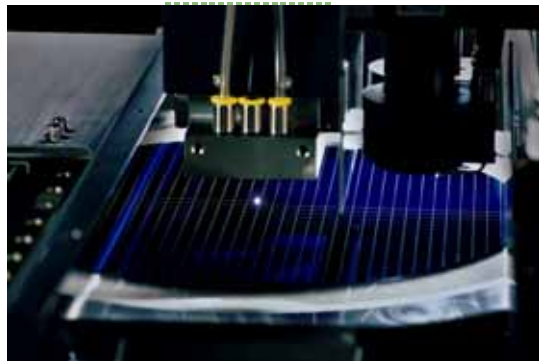
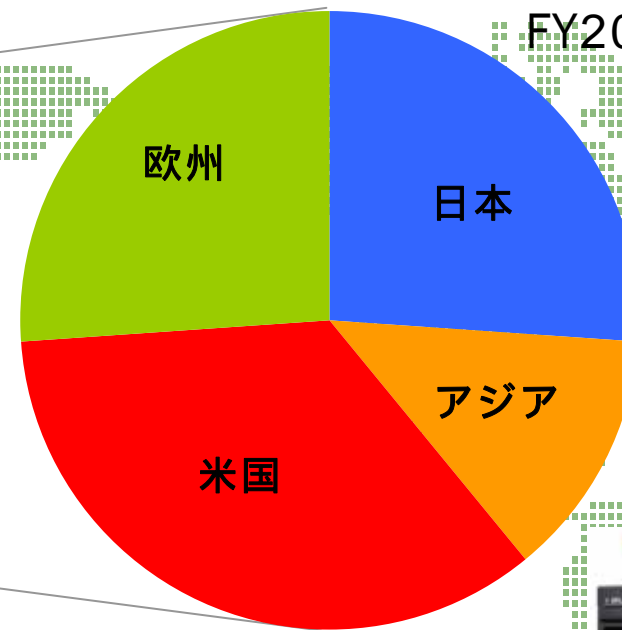
レーザー(DFL7160)

アプリケーション拡大に伴い売上伸張
特に06年度はLED向の伸びが顕著

FY2005



FY2006



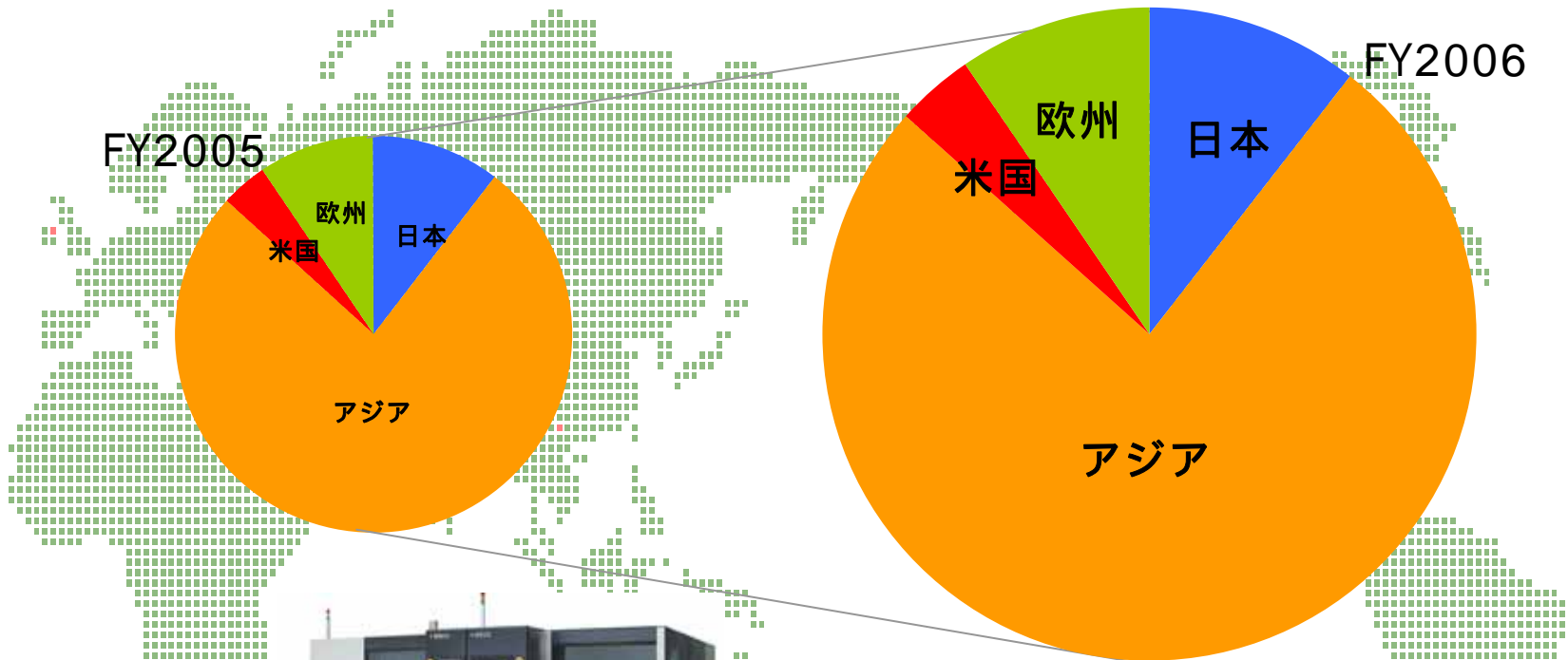
DFL7160

Disco Fully Automatic Laser Saw



薄化・ストレスリリース装置

デバイスメーカーの投資継続により大幅伸張
ウェーハ厚は07年には50 μmを切る水準へ



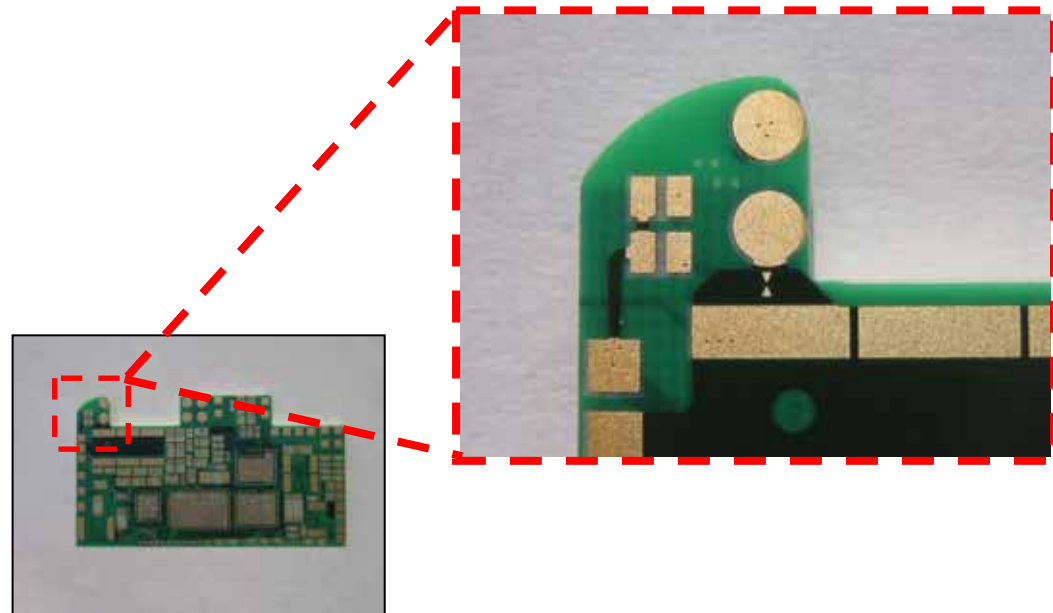
DGP8760 /DFM2700インラインシステム

DGP: Disco Fully Automatic Grinder/Polisher
 DBG: Dicing Before Grinding
 DFP: Disco Fully Automatic Polisher

ウォータージェットソー (DAW4110)

アプリケーション：非熱・曲線加工が特長
半導体市場に限定せず、顧客と
共にアプリケーション開発中

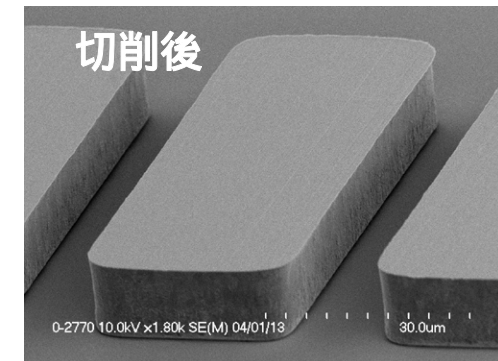
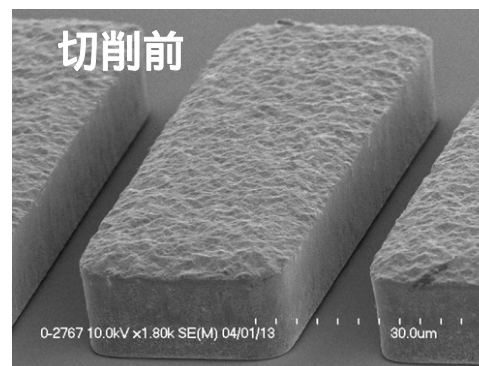
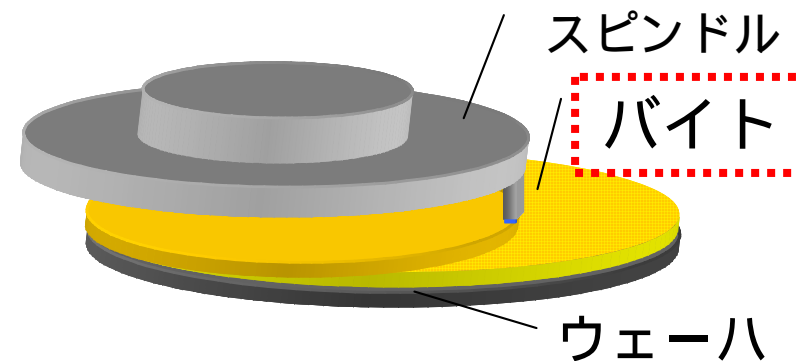
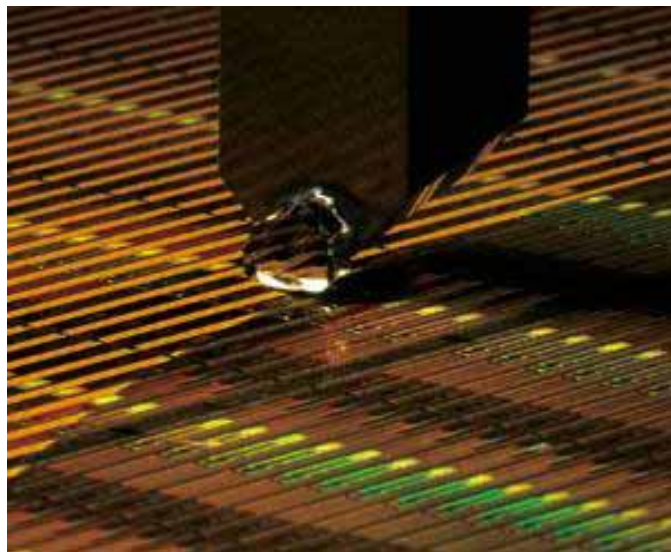
販売状況： 06年度開始予定 07年度へ



サーフェースプレーナー（DFS8910）

アプリケーション：LCDドライバのAuバンプ平坦化、
樹脂、金属（金/銅/アルミ）加工

販売状況： 06年度実績あり



TAIKO プロセス

アプリケーション：外周枠が残っているため
ハンドリングが容易
(反り低減・強度向上・エッジチップング減)

販売状況： 06年度実績あり

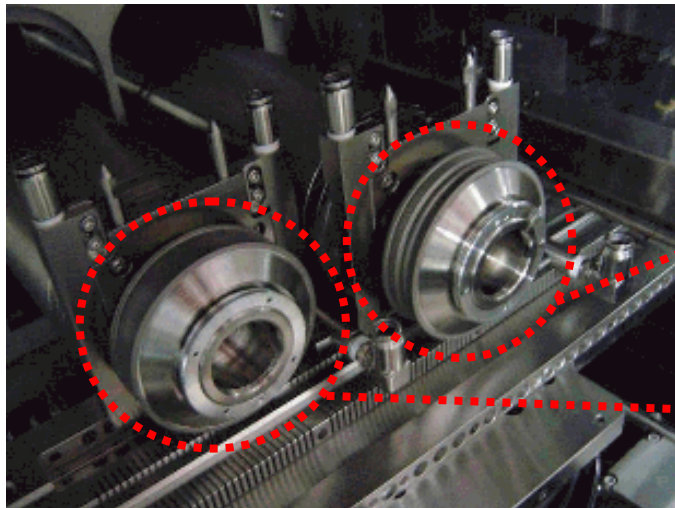
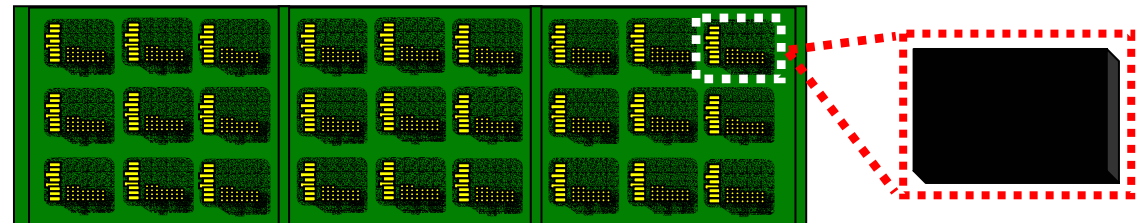


エッジプロファイルグラインディング

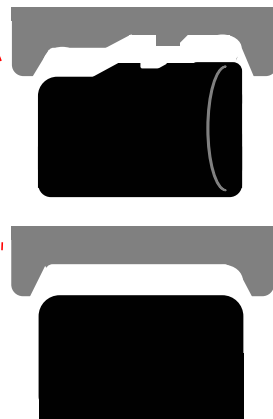
アプリケーション：小型メモリーカード異形加工

販売状況：06年度実績あり

メモリ基板シンギュレーション



エッジプロファイル グラインディング



完成品



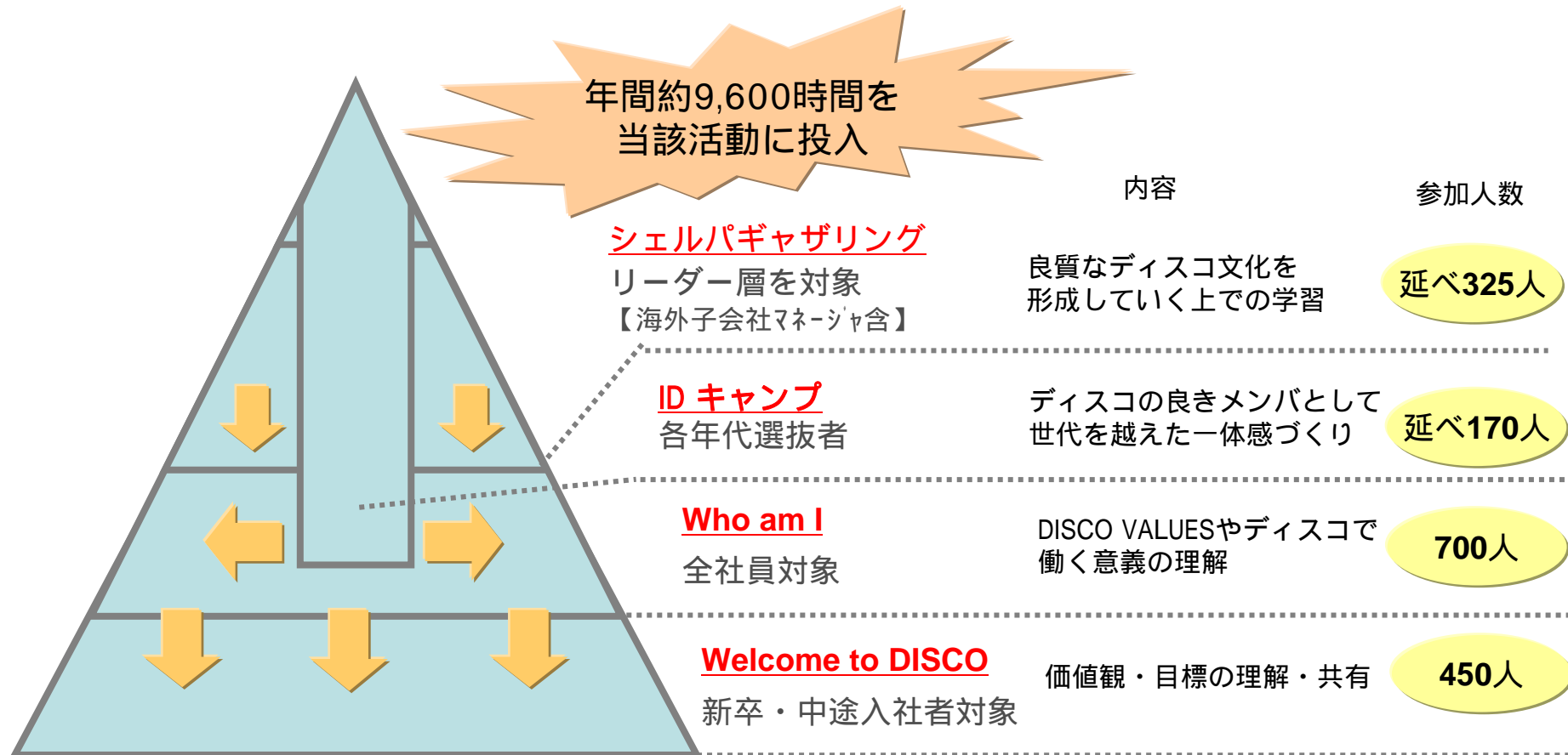
1. 経営成績等について

- 1 2007年3月期概況
- 2 2008年3月期見通し
- 3 技術動向
- 4 経営方針**

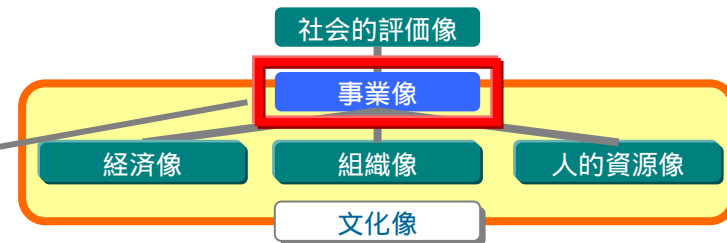
DISCO VALUES実践活動

DISCO VALUESはディスコ文化の核
企業文化を更に根強いものにするため

実践のための浸透活動の展開



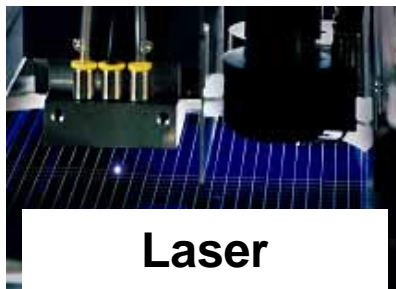
© Gray Institute of Management



- 「**Kiru・Kezuru・Migaku**ならディスコ」とハイテク業界において、最も頼られる存在となっている
 - アブレイシブの他に複数のKiru・Kezuru・Migaku技術が事業の柱になっている
 - 消耗品ビジネスが固定費の大半を賄っている

DISCO VISION 事業像

- アブレイシブの他に複数の
Kiru・Kezuru・Migaku技術が事業の柱になっている



出荷開始: **2003年度**
アプリケーション: Low-k膜、TEG、化合物半導体、サファイア
薄Siウェーハ、DAF etc.
06年度はLED(サファイア)加工向を中心に伸張









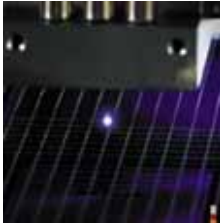



出荷開始: **2004年度**
アプリケーション: 薄ウェーハストレスリリース用途中心
DBGシステム・DGP8760との組合せで使用
薄ウェーハソリューションラインアップの一つ



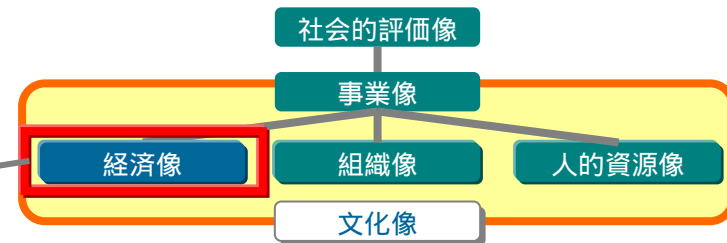
出荷開始: **2007年度予定**
アプリケーション: 非熱・曲線加工が特長
半導体市場に限定せず、顧客と共に
アプリケーション開発中

DISCO VISION 事業像

- 消耗品ビジネスが固定費の大半を賄っている
 - 消耗品ビジネス売上高 200億円をターゲット

半導体			電子部品	ウェーハ
back grinding	wafer dicing	package singulation	back grinding	surface grinding
				
stress relief	laser groove/full cut (laser head)	edge profile grinding	dicing	その他
				water jet dicing (nozzle/abrasive) 

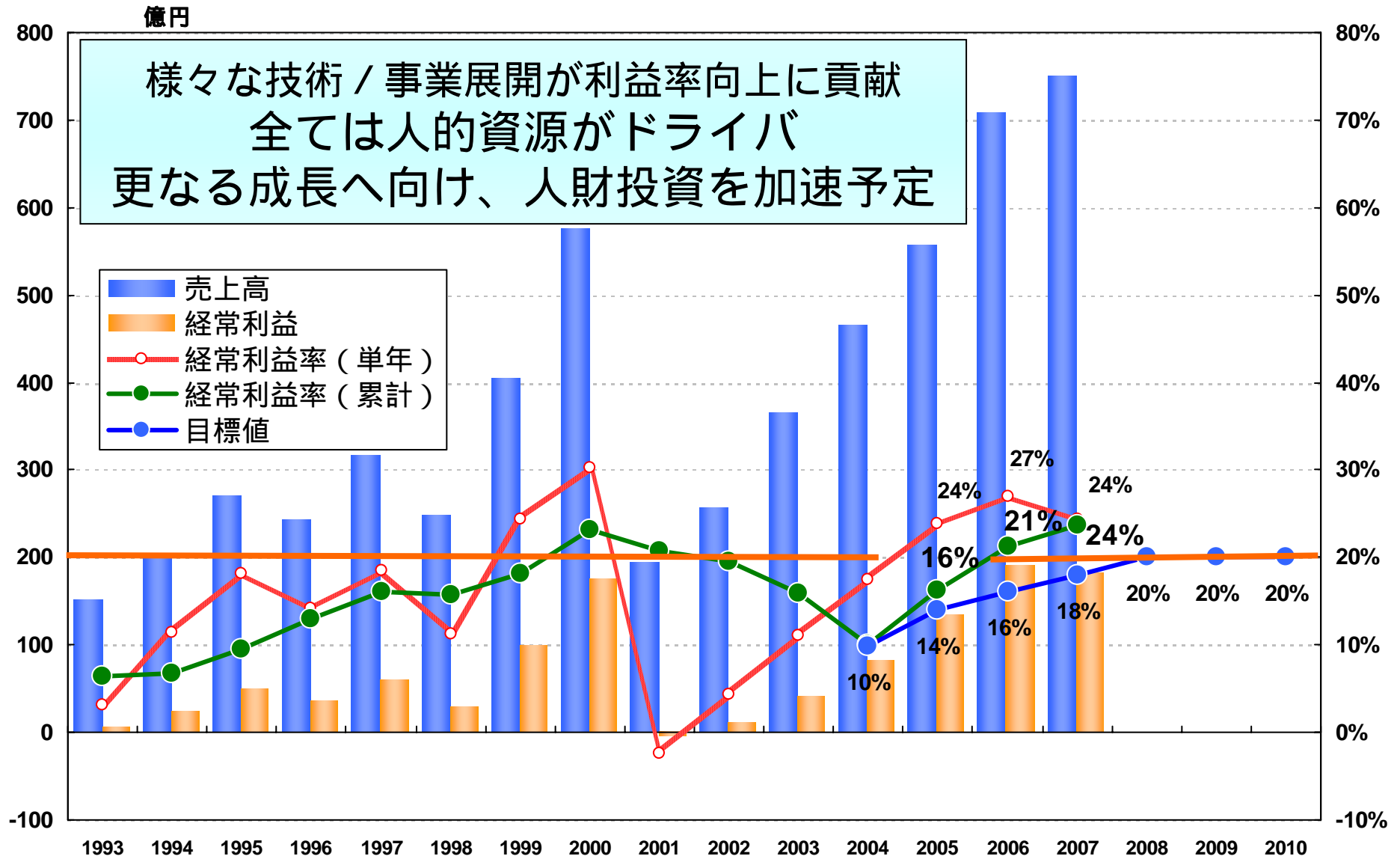
15,000品種ラインアップ



- 企業の成長を支える十分な経済的「能力と構造」を持っている

– 4年累計で、**20%以上の売上高経常利益率**を維持する態勢が出来ている

目標達成のマイルストーン



Mission

高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって
遠い科学を身近な快適につなぐ

Kiru



Dicing saw



Dicing Blade



Laser saw



Laser Head

半導体

IC/パッケージ/LED/etc.

電子部品

セラミックコンデンサ/SAWフィルタ/etc.

Kezuru



Grinder



Grinding Wheel

Migaku



Grinder / Polisher



Polishing Wheel

半導体

IC/etc.

電子部品

SAWフィルタ/etc.

ウェーハ

配当について

	中間期	期末	年間
2007年3月期	30円	(*1) 45円 (予想)	75円 (予想)
2008年3月期(予想)	30円	39円	69円
(ご参考) 2006年3月期(実績)	15円	35円	50円

(*1) 創業70周年記念として10円の記念配当を予定

【配当方針】

連結業績に連動した配当（配当性向20%）

安定配当として最低20円の配当金を維持。

ただし3期連続で連結純損失の場合を除く。

赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が

予定必要資金額(*2)を超過した場合は、上記に加え、

超過金額の3分の1を目処に配当に上乘せする

*2 2007年3月期末時点予定必要資金額 300億円

現預金残高が予定必要資金額を超過しないため配当金の上乗せはなし

終

ありがとうございました

本日の説明

1. 経営成績等について

代表取締役社長

溝呂木 育

2. 財務諸表について

常務取締役 IR室担当

関家圭三

3. 質疑応答

業績予想との比較 / 連結財政状態

短信P.1

(1) 業績予想(2006年11月)との比較

単位：百万円

	06.11.13発表 予測	07年3月期 実績	増減	増減(率)
売上高	85,000	86,160	1,160	1.4%
営業利益	19,800	19,524	276	1.4%
営業利益率	23.3%	22.7%	0.6%	2.7%
経常利益	19,700	19,667	33	0.2%
経常利益率	23.2%	22.8%	0.4%	1.5%
純利益	10,800	10,936	136	1.3%

(2) 連結財政状態

単位：百万円

	06年3月期 実績	07年3月期 実績	増減	増減(率)
総資産	99,318	113,791	14,473	14.6%
純資産	70,276	81,823	11,547	16.4%
自己資本比率	70.8%	71.5%	0.7%	1.0%
一株当純資産(円)	2,092	2,393	302	14.4%

連結損益計算書

単位：百万円

短信P.13 ~ 14

	06年3月期	07年3月期	増減
売上高	68,885	86,160	17,275
売上総利益	36,150	44,054	7,903
GP率	52.5%	51.1%	-1.4%
販売費・一般管理費	22,201	24,529	2,328
営業利益	13,949	19,524	4,080
営業利益率	20.2%	22.7%	2.5%
営業外収益	590	497	92
営業外費用	129	354	225
経常利益	14,410	19,667	5,257
経常利益率	20.9%	22.8%	1.9%
特別利益	16	309	292
特別損失	1,041	2,261	1,219
税金等調整前純利益	13,385	17,715	4,330
法人税等	5,077	7,450	2,373
法人税等調整額	18	720	738
少数株主利益	58	49	9
純利益	8,230	10,936	2,705

GP率 1.4Pダウン

- 相対的にGP率の低い仕入れ商品売上増
- 一部の装置製品販売価格ダウン

販管費増 23億

- 販売増に伴い変動費増 8億
- 人件費増 7億
- 減価償却費増 1億
- その他

特別利益 3億

- 有価証券売却益

特別損失 22億

- 資産評価/廃棄/除却損 11億
- 産業研削製品事業関連 6億
- 有価証券評価損 3億
- 役員功労金 2億

実効税率 約38%

連結貸借対照表（資産項目）

短信P.10

単位：百万円

	06年3月31日	07年3月31日	増 減
流動資産	64,279	75,799	11,520
現預金	22,003	27,045	5,042
受取手形・売掛金	24,424	27,797	3,373
棚卸資産	15,749	17,283	1,534
その他	2,101	3,673	1,572
固定資産	35,039	37,991	2,951
有形固定資産	29,057	33,603	4,546
建物・構築物	11,419	11,099	320
機械装置・運搬具	4,360	4,835	475
土地	12,206	12,457	251
その他	1,071	5,210	4,139
無形固定資産	758	925	166
その他固定資産	5,223	3,462	1,761
資産合計	99,318	113,791	14,472

現預金増 50億

- ・ 07.3月期時点での必要資金を300億円と考えており、270億円という現預金残高は過大とは考えていない

受取手形・売掛金増 30億

- ・ 売上高の増加に伴う増

建設仮勘定 45億

- ・ 本社R&D棟拡張、桑畑工場/呉工場建替え着手金計上による

投資有価証券減 14億

- ・ 有価証券売却、評価減による

連結貸借対照表（負債・資本項目）

単位：百万円

	06年3月31日	07年3月31日	増 減
流動負債	25,493	28,819	3,325
支払手形・買掛金	11,825	12,894	1,069
短期借入金	606	300	306
一年以内償還新株予約権付社債	1,985	0	1,985
未払法人税等	3,795	4,681	886
その他	7,282	10,944	3,662
固定負債	3,123	3,148	25
長期借入金	700	828	128
その他	2,422	2,320	102
少数株主持分	424	-	-
資本合計	70,276	-	-
資本金	13,412	-	-
資本剰余金	14,494	-	-
利益剰余金	41,899	-	-
その他有価証券評価差額金	303	-	-
為替換算調整勘定	205	-	-
自己株式	39	-	-
負債・少数株主持分・資本合計	99,318	-	-
株主資本合計	-	80,551	-
資本金	-	14,485	-
資本剰余金	-	15,567	-
利益剰余金	-	50,553	-
自己株式	-	53	-
評価・換算差額等合計	-	755	-
その他有価証券評価差額金	-	59	-
為替換算調整勘定	-	696	-
新株予約権	-	65	-
少数株主持分	-	450	-
負債純資産合計	-	113,791	-

短信P.11～12

社債繰上償還 20億
 ・ 2006.4償還済

未払費用増 36億
 ・ 設備投資未払金等

業績予想詳細 (連結)

単位：百万円

短信P.1

	08年3月期	
	中間期 見通し	通期 見通し
売上高	45,900	93,500
営業利益	9,700	20,000
営業利益率	21.1%	21.4%
経常利益	9,700	20,000
経常利益率	21.1%	21.4%
純利益	5,900	11,700

売上高

- 対前期比74億増 (+8.6%)
- 特にグラインダ/精密加工ツールの伸張を想定
- 受注高は売上高同水準を想定

販管費

- 対前年比10%程度増を想定
 - R&D費用増
 - 採用増に伴う人件費増
 - 売上増に伴う変動費増

特別損失

- 廃棄損関連3億程度を想定

法人税

- 実効税率40%程度を想定

	為替前提
US\$	115 円
EUR	145 円
SGP\$	70 円

当社製品価格設定はJP¥/US\$/Euro/SGP\$等。
 何れも¥価格をベースに外為環境を考慮し外貨建価格を設定。
 円建て売上高には、為替による大きな影響はなし
 但し、保有外貨に対する評価損益は発生

本日の説明

1. 経営成績等について

代表取締役社長

溝呂木 育

2. 財務諸表について

常務取締役 IR室担当

関家圭三

3. 質疑応答

終

ありがとうございました

DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies

